

## 電子機器実装用低温・短時間硬化接着剤

### The Low Temperature And The Short-Time Hardening Adhesives For Electronic Device Mounting

伊達 仁昭

H. Date

富士通クオリティ・ラボ株式会社

FUJITSU QUALITY LABORATORY LIMITED

モバイル端末等、電子機器の高機能化に伴ってチップ部品やパッケージ等の実装部品、および基板の小型・軽量・薄型化が大きく進展している。一方、実装材料として用いられている鉛フリーはんだは実装温度が高く、小型・薄型化した実装部品や基板に対応するためには、部材間に生じる熱ストレスを抑制する必要がある、実装温度の低減が重要となっている。さらに、実装コスト削減の観点から、短時間で実装できる材料に対するニーズが大きい。このような要求に対応するために、我々は“低温・短時間硬化”を特徴とする電子機器実装用接着剤の開発を行っている。本稿では“低温・短時間硬化”を特徴とするエポキシ樹脂をベースとした接着剤について紹介する。